

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和2年12月17日(2020.12.17)

【公開番号】特開2019-176158(P2019-176158A)

【公開日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【年通号数】公開・登録公報2019-041

【出願番号】特願2019-81610(P2019-81610)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

C 09 J 7/38 (2018.01)

C 09 J 7/30 (2018.01)

C 09 J 201/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/78 M

C 09 J 7/38

C 09 J 7/30

C 09 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】令和2年10月30日(2020.10.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材フィルムと、前記基材フィルムの少なくとも一面側に形成された粘着剤層とを有する粘着テープを有し、

前記基材フィルムは、アイオノマー樹脂を除く熱可塑性架橋樹脂からなり、

前記粘着テープは、MD方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した40~80の間の1毎の熱変形率の平均値と、TD方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した40~80の間の1毎の熱変形率の平均値との和がマイナス値であることを特徴とする半導体加工用テープ。

【請求項2】

前記粘着剤層側に、接着剤層が積層されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体加工用テープ。

【請求項3】

フルカットおよびハーフカットのブレードダイシング、レーザーダイシング、またはレーザーによるステルスダイシングに用いられることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の半導体加工用テープ。